

Title (en)

Method and glueing device for continuously applying an adhesive on webs

Title (de)

Verfahren und Leimwerk zum fortlaufenden Beleimen von Bahnen

Title (fr)

Procédé et dispositif pour l'application continue d'un adhésif sur des bandes

Publication

**EP 1481793 A2 20041201 (DE)**

Application

**EP 04011605 A 20040515**

Priority

DE 10324729 A 20030531

Abstract (en)

Process for continuous gluing of webs, especially the top of the corrugations (21) of corrugated cardboard webs (17), comprises transporting glue from a glue reservoir into a first dosing gap (26), dosing the glue into a second dosing gap (28) arranged downstream of the first dosing gap, and applying the glue onto the web. An independent claim is also included for a gluing device for carrying out the above process. Preferred Features: The glue is applied by squeezing.

Abstract (de)

Ein Leimwerk für eine Wellpappebahn (17) weist ein Gestell (1) auf, in dem eine Leim-Auftragswalze (5) und eine unterhalb hiervon angeordnete Leim-Vordosierwalze (10) und eine neben der Auftragswalze (5) angeordnete Leim-Nachdosierwalze (12) jeweils drehantreibbar gelagert sind. Zwischen der Leim-Vordosierwalze (10) und der Leim-Auftragswalze (5) wird ein Leim-Vordosier-Spalt (26) gebildet, in dem eine Vordosierung des Leims stattfindet. Zwischen der Leim-Auftragswalze (5) und der Leim-Nachdosierwalze (12) wird ein Leim-Nachdosier-Spalt (28) gebildet, in dem eine abschließende Nachdosierung und Kalibrierung des Leimfilms erfolgt. <IMAGE>

IPC 1-7

**B31F 1/28; B05C 1/08**

IPC 8 full level

**B05C 1/08** (2006.01); **B31F 1/28** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B05C 1/0834** (2013.01 - EP US); **B31F 1/2818** (2013.01 - EP US); **Y10T 156/1025** (2015.01 - EP US)

Cited by

EP3398765A1; EP3401090A1; US10894379B2; US10894378B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 1481793 A2 20041201; EP 1481793 A3 20050817**; CN 1572481 A 20050202; DE 10324729 A1 20041216; US 2004241328 A1 20041202

DOCDB simple family (application)

**EP 04011605 A 20040515**; CN 200410046110 A 20040531; DE 10324729 A 20030531; US 85584204 A 20040528